

TopTac™-2000 Application Note

Reference No. CL-APPL-TT-01

Purpose Adhesion test

Samples 반도체 dicing process 에서 사용된 점착제

Conditions Measuring cell **TopTac™-2000**

Testing method

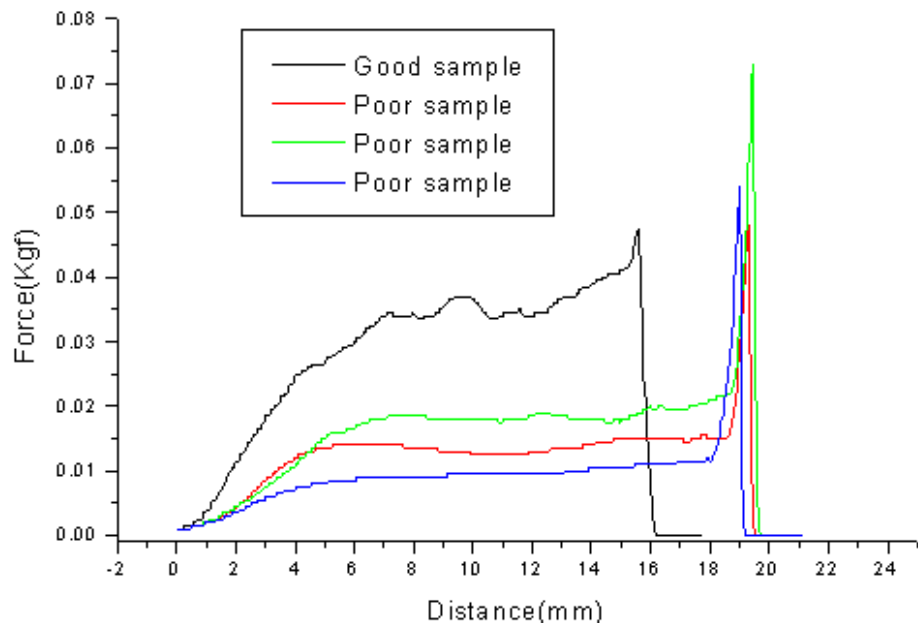
- Descending: 0.1mm/sec
- Dwell force and time: 50gf, 30 sec
- Ascending: 0.1mm/sec

Pretreatment Nothing particular

Jig 1 inch Half Ball, SS



Diagram



Discussion

Dicing 공정에서 사용되는 점착제는 wafer cutting 작업(sawing) 시 접착력이 좋아야 하는 반면, 잘려진 wafer 를 pick-up 하는 공정에서는 wafer 를 잘 떼어지게 하는 역할을 수행한다.

그래프에서 good sample 은 이러한 공정을 잘 수행하는 sample 이고 poor sample 의 경우는 sawing 작업과 pick-up 작업에서 문제가 발생한 sample 의 경우이다.

The experiments discussed in this report have been conducted and evaluated according to the current state of our knowledge. However, responsibility for any consequences that might follow from the use of these data is declined.

(주)연진코퍼레이션

서울특별시 영등포구 당산동 4 가
 32-141 연진빌딩 3 층
 02)2675-0508 Fax: 02)2675-0567
<http://www.yeonjin.com>

점착력측정기 / 열전도도 · 열확산율측정기
 고온고압 고주파점도계 / 재료시험기 (UTM)
 가속속도열량계(ARC) / 유전율분석기 (DEA)
 열분석 및 점착력 시험분석서비스
 열전도도 (ASTM E1530) 시험분석 서비스